

TAZMO

タツモ株式会社 決算説明資料

2024年12月期

2025年2月17日

証券コード 6266

会社案内ダウンロード



INDEX

目次



01

2024年12月期 決算報告

02

2024年12月期 セグメント別業績

03

2025年12月期 業績予想

04

新技術紹介

05

補足資料



01

2024年12月期 決算報告

売上高はほぼ計画通り、利益は収益性向上により当初計画を大きく上回り、増収増益

売上高

35,865百万円

前期比 +27.4%

営業利益

5,917百万円

前期比 +61.9%

経常利益

5,998百万円

前期比 +54.2%

親会社株主に帰属 する当期純利益

4,247百万円

前期比 +80.2%

概況

- プロセス機器事業の半導体装置と表面処理用機器事業の売上高と利益の伸びが大きく、業績をけん引した
- 半導体装置においては、過去に受注したパワー半導体向け案件と、2024年12月期も引き合いが好調な先端パッケージ向け装置が売上・利益の増加に寄与
- 年初では一部で検収や設備投資の遅れが発生するも、大部分は期内で検収に持ち込むことができた
- 研究開発の未消化と子会社の減損処理が発生

受注案件が概ね予定通り進み増収増益。特に当期純利益は前期比で大幅に増加。

(百万円)	2023年12月期 実績	2024年12月期		前期比 増減率(%)	2024年12月期 当初計画	当初計画比 (%)
		実績	売上比(%)			
売上高	28,161	35,865	—	27.4	36,000	△0.4
売上総利益	8,558	11,855	33.1	38.5	—	—
営業利益	3,654	5,917	16.5	61.9	4,600	28.6
経常利益	3,890	5,998	16.7	54.2	4,500	33.2
親会社株主に帰属する 当期純利益	2,356	4,247	11.8	80.2	3,060	38.8
自己資本利益率 (ROE)	12.7%	19.3%	—	6.6P	—	—

5期連続の増収増益。売上高は前年比27.4%増、営業利益率は過去最高の16.5%を達成



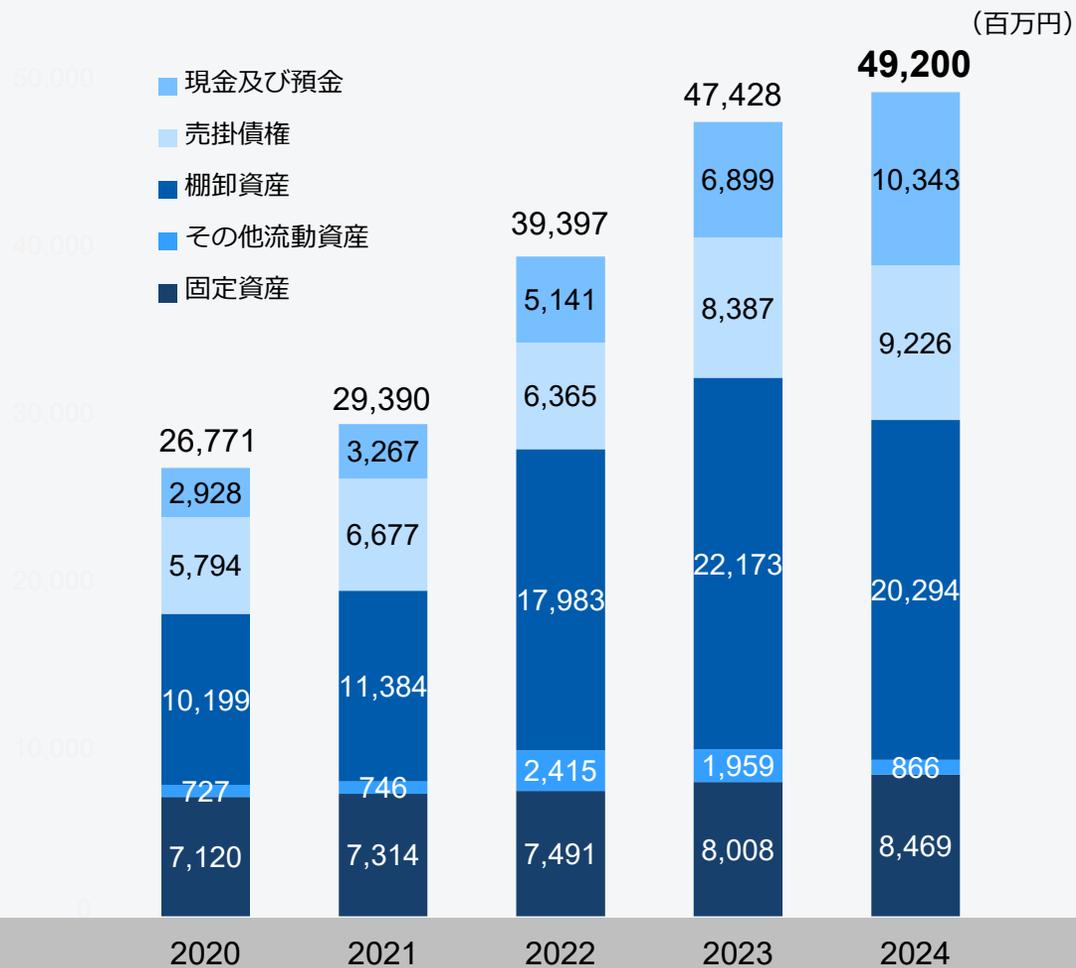
現金及び預金の増加、仕掛品の減少、有利子負債の減少により財務状況が大きく改善

(百万円)	2023年12月期	2024年12月期	前期比 増減率(%)
流動資産	39,420	40,731	3.3
固定資産	8,008	8,469	5.8
有形固定資産	7,007	7,385	5.4
無形固定資産	157	156	△0.9
投資その他資産	842	927	10.1
総資産合計	47,428	49,200	3.7
流動負債	21,380	17,696	△17.2
固定負債	5,952	6,861	15.3
負債合計	27,333	24,557	△10.2
純資産合計	20,095	24,642	22.6
自己資本比率	41.7%	49.1%	7.4P

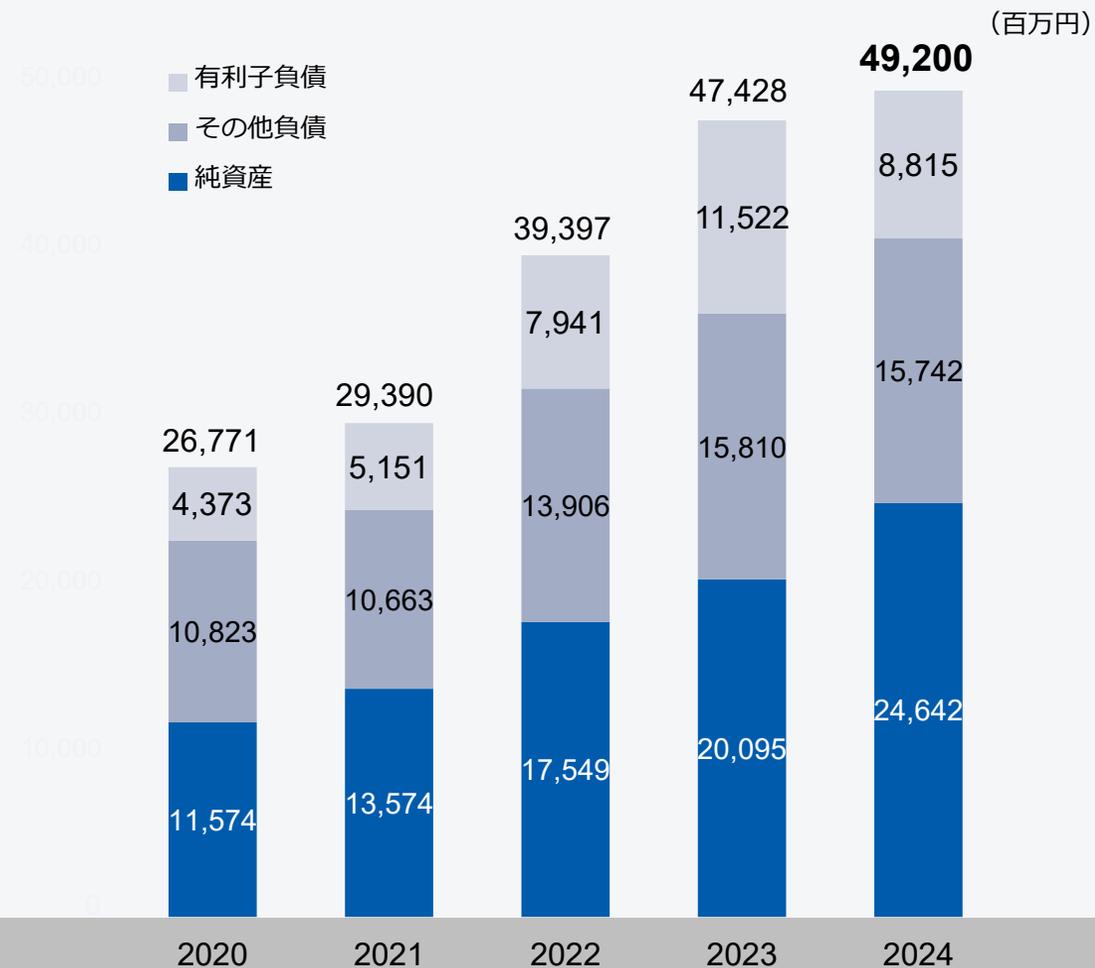
主な増減要因 (前期比)

流動資産	(百万円)
現金及び預金	+3,443
仕掛品	△1,143
その他	△997
流動負債	
短期借入金	△3,623
固定負債	
長期借入金	+905

資産



負債／純資産



棚卸資産が減少したことなどにより営業活動によるキャッシュ・フローが改善

(百万円)	2023年12月期	2024年12月期	前期比 増減率(%)
営業活動による キャッシュ・フロー	△350	7,506	—
投資活動による キャッシュ・フロー	△1,258	△1,710	35.9
フリー・キャッシュ・ フロー	△1,608	5,796	—
財務活動による キャッシュ・フロー	3,211	△3,163	—
現金及び現金同等物の 期末残高	6,771	9,733	43.7

主な内訳

営業CF	(百万円)
税金等調整前当期純利益	5,824
棚卸資産の増減額 (増加: △)	2,081
その他流動資産 (増加: △)	1,043
投資CF	
定期預金の純増減額 (増加: △)	△468
有形固定資産の取得による支出	△1,168
無形固定資産の取得による支出	△50
財務CF	
長期借入金の返済による支出	△2,718
配当金の支払い	△355



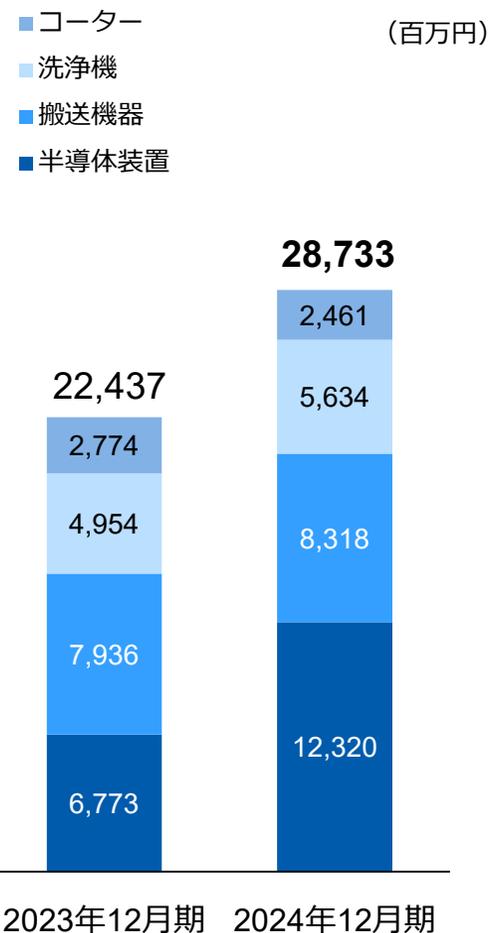
02

2024年12月期 セグメント別業績

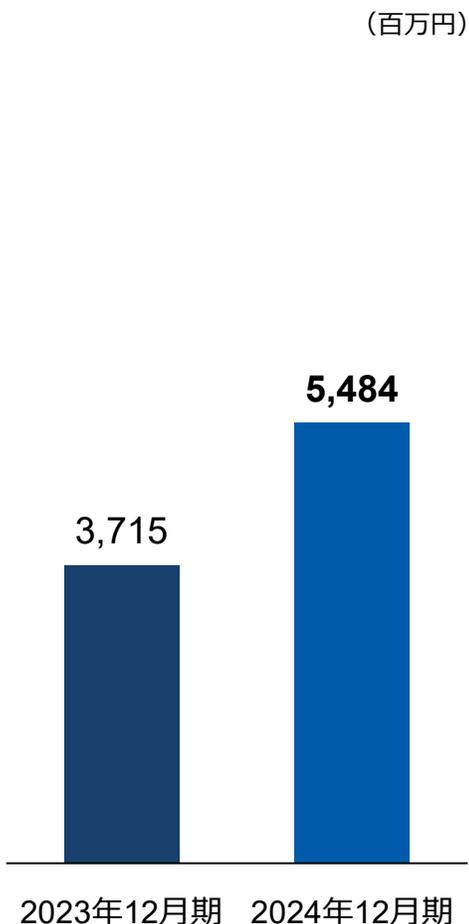
2024年12月期 セグメント別業績ハイライト

				前期比 増減率(%)	2024年12月期 当初計画	計画比 増減率(%)	
		2023年12月期 実績	2024年12月期 実績				
(百万円)							
プロセス機器事業	売上高	22,437	28,733	28.1	27,770	3.5	
	営業利益	3,715	5,484	47.6	4,250	29.0	
	■ 半導体装置	売上高	6,773	12,320	81.9	11,500	7.1
	■ 搬送機器	売上高	7,936	8,318	4.8	8,100	2.7
	■ 洗浄機	売上高	4,954	5,634	13.7	5,800	△2.9
■ コーター	売上高	2,774	2,461	△11.3	2,370	3.8	
金型・樹脂成形事業	売上高	1,456	779	△46.5	1,700	△54.2	
	営業利益	△29	△128	—	30	—	
表面処理用機器事業	売上高	4,267	6,352	48.9	6,530	△2.7	
	営業利益	△22	578	—	320	80.6	
セグメント間連結消去	営業利益	△8	△17	—	—	—	
合計	売上高	28,161	35,865	27.4	36,000	△0.4	
	営業利益	3,654	5,917	61.9	4,600	28.6	

売上高



営業利益



概況

- 半導体装置：パワー半導体向け装置に先端パッケージ向け装置が追加され、売上・利益に大きく貢献
- 搬送機器：内外の連携が進み、生産性の改善が利益に寄与
- 洗浄機：概ね計画通りの検収が進み昨年比で増収
- コーター：FPD向けは終了、PLP向け装置に注力

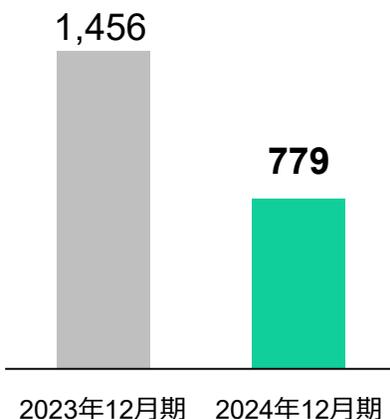
市場の状況

- ✓ EV市場の減速もあり、パワー半導体向け装置は投資計画の遅延もあり、受注は低調に推移した
- ✓ 先端パッケージ向け装置は、上期は不透明感があったが、年間通じて継続的に投資があり、売上と受注を計上
- ✓ 先端パッケージはウェーハ（WLP）からパネル（PLP）に拡大、試作・量産向け装置の投資計画とその引き合いが増加
- ✓ 半導体市場の全体的な投資は低調が続いており、搬送機器や洗浄機については、個別案件への対応が増加傾向

金型・樹脂成形事業

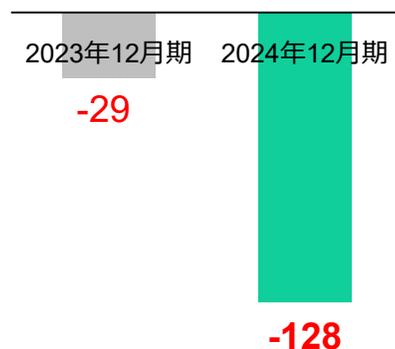
売上高

(百万円)



営業利益

(百万円)



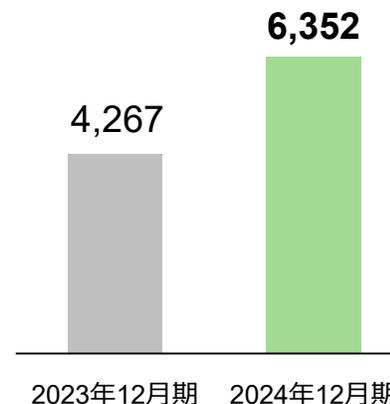
コネクタメーカーの在庫調整が長引き、電子部品の需要が減少し業績悪化

中国市場の低迷も続くことから、本事業内容の絞り込みと固定費削減（人員の他事業への異動含む）を行い、事業構造の転換を実施

表面処理用機器事業

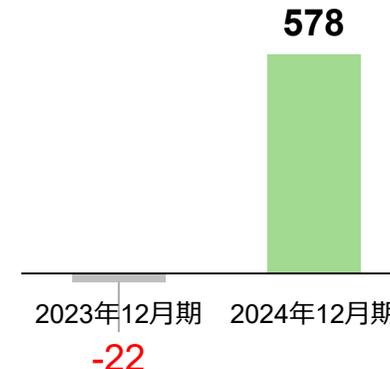
売上高

(百万円)



営業利益

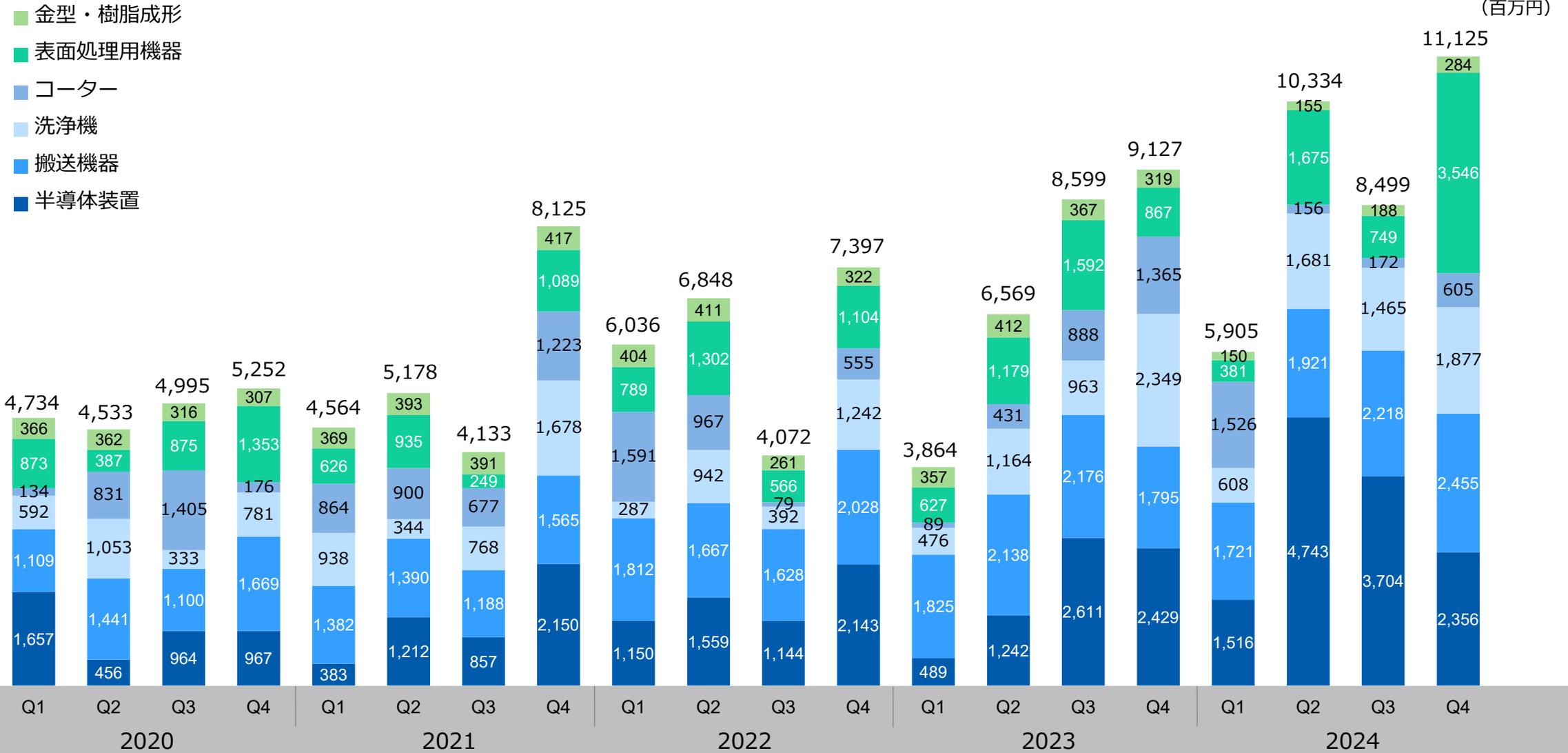
(百万円)



見積もり精度向上とユニット化への対応による工数削減を進めたことにより、営業利益率が大きく改善

納入や検収時期が遅延していた大口案件も検収が進み、売上が拡大し利益にも貢献

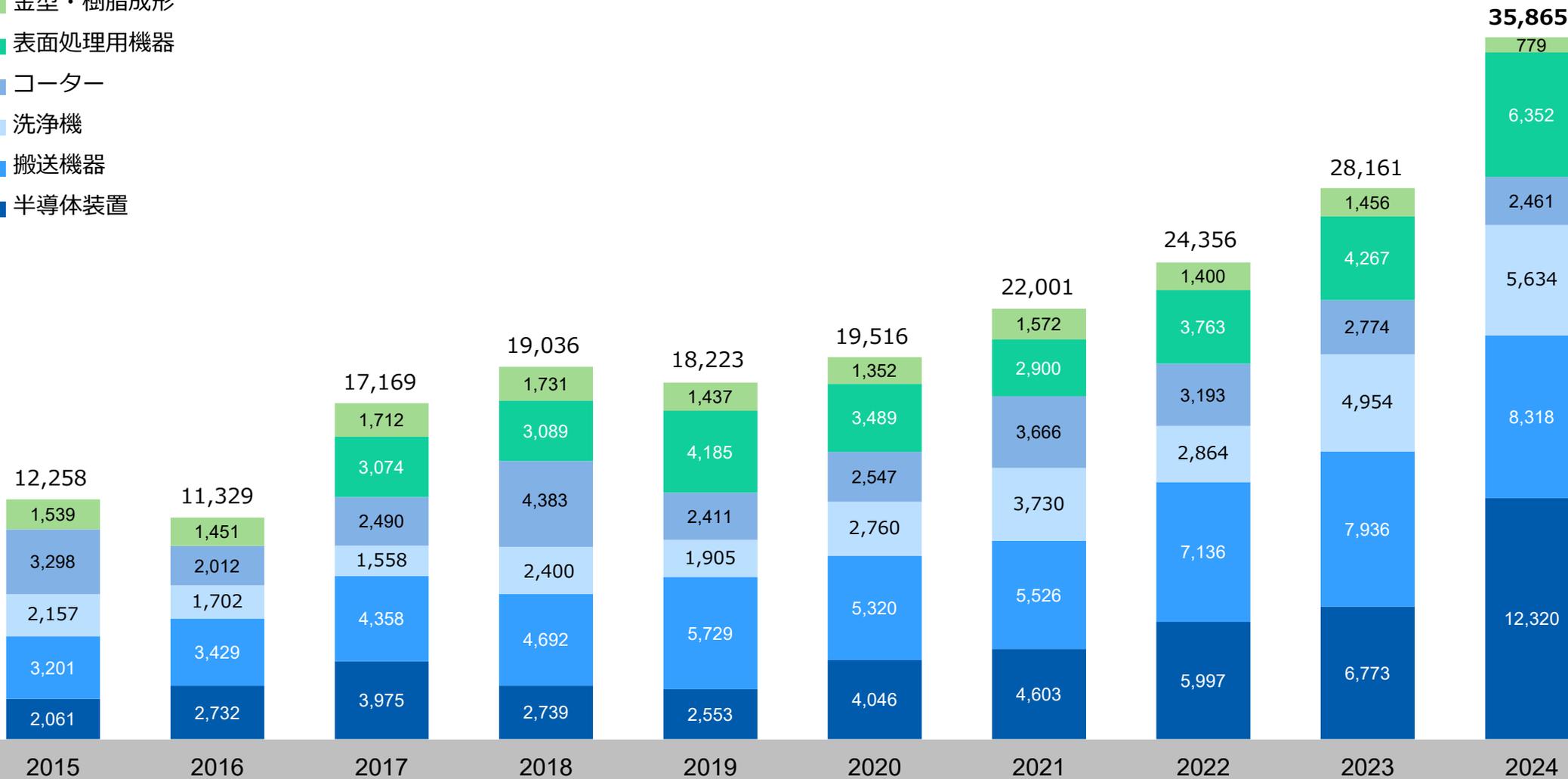
セグメント別 売上高推移 (四半期)



セグメント別 売上高推移 (通期)

(百万円)

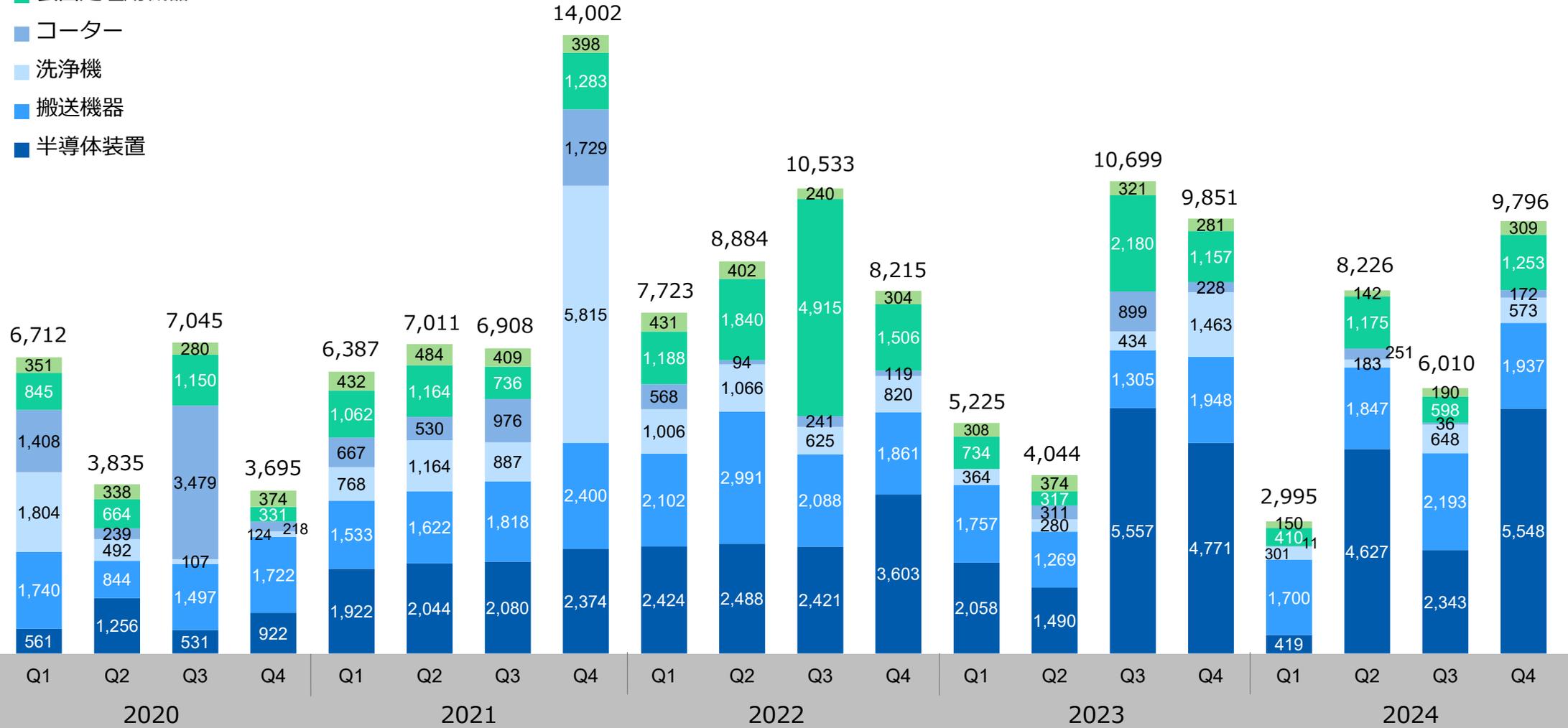
- 金型・樹脂成形
- 表面処理用機器
- コーター
- 洗浄機
- 搬送機器
- 半導体装置



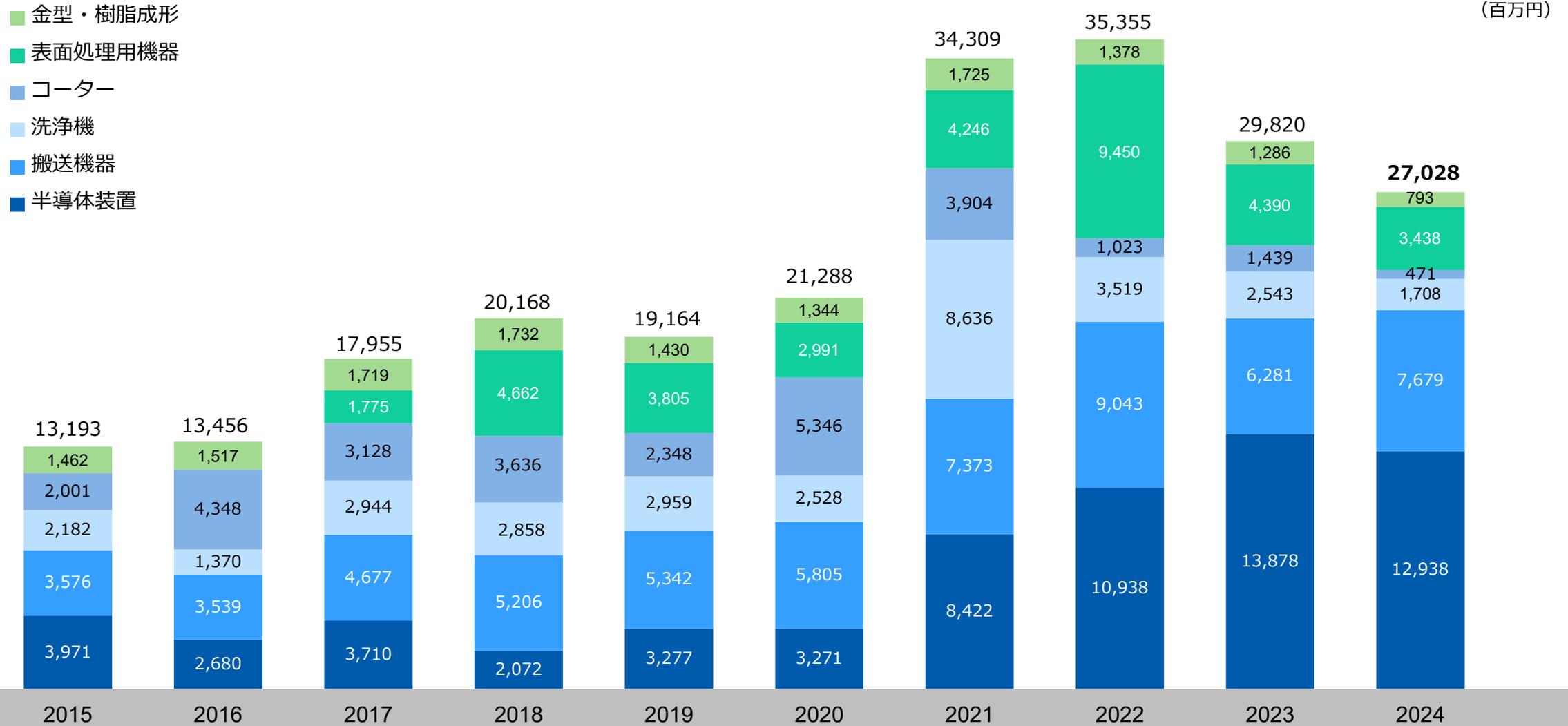
セグメント別 受注高推移 (四半期)

(百万円)

- 金型・樹脂成形
- 表面処理用機器
- コーター
- 洗浄機
- 搬送機器
- 半導体装置

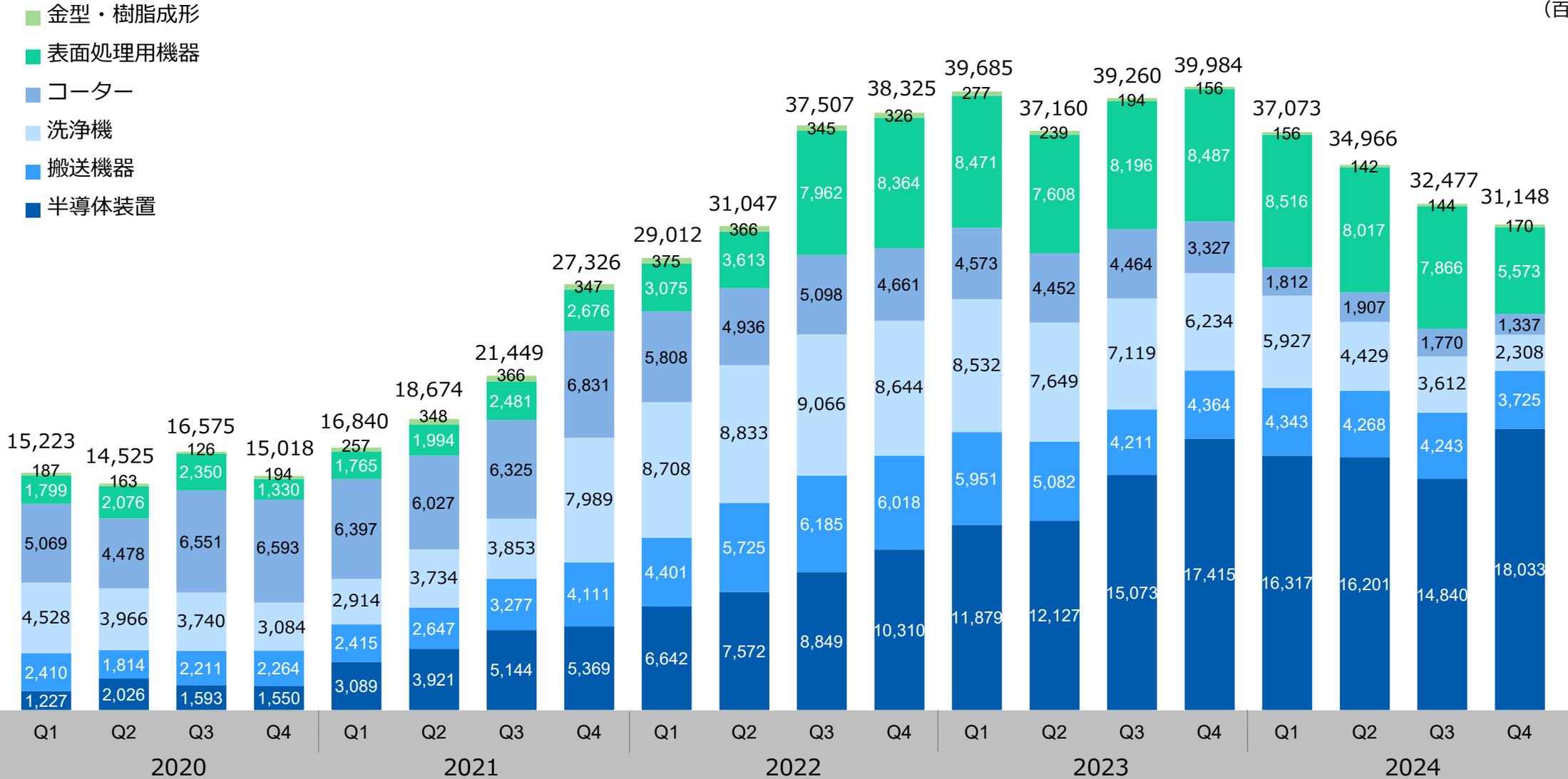


セグメント別 受注高推移 (通期)



セグメント別 受注残高推移

(百万円)





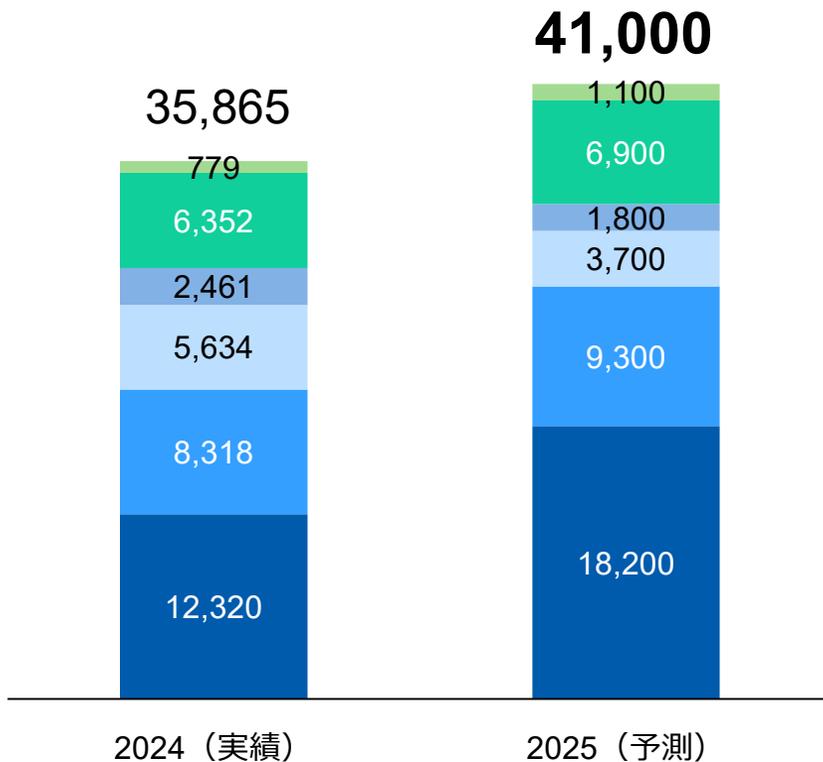
03

2025年12月期 業績予想

(百万円)	第2四半期累計	通期	通期 前期比 増減率 (%)
売上高	18,640	41,000	14.3
プロセス機器事業	13,900	33,000	14.8
金型・樹脂成形事業	540	1,100	41.2
表面処理機器事業	4,200	6,900	8.6
営業利益	1,930	5,000	△15.5
プロセス機器事業	1,550	4,500	△17.9
金型・樹脂成形事業	20	50	—
表面処理機器事業	360	450	△22.2
経常利益	1,920	5,100	△15.0
親会社株主に帰属する当期純利益	1,350	3,500	△17.6

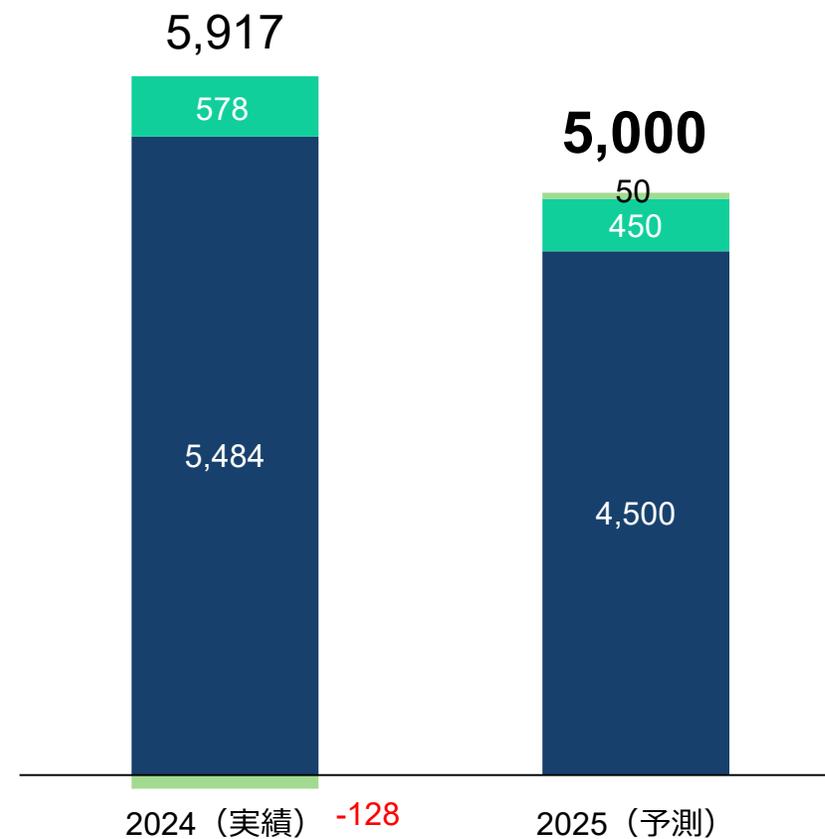
売上高

- 金型・樹脂成形
 - コーター
 - 搬送機器
 - 表面処理用機器
 - 洗浄機
 - 半導体装置
- (百万円)



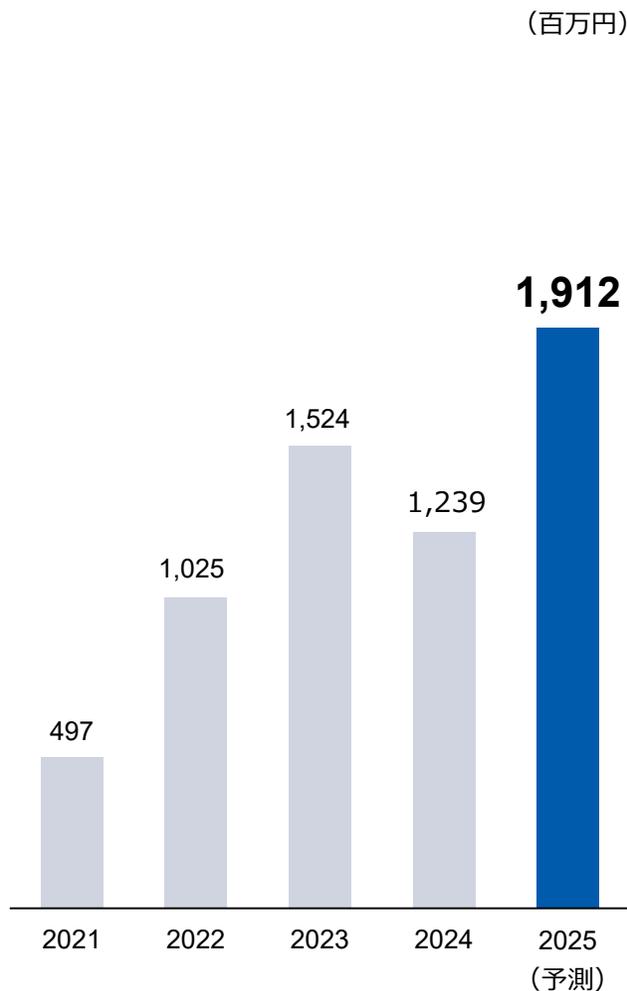
営業利益

- 金型・樹脂成形
 - 表面処理用機器
 - プロセス機器
- (百万円)



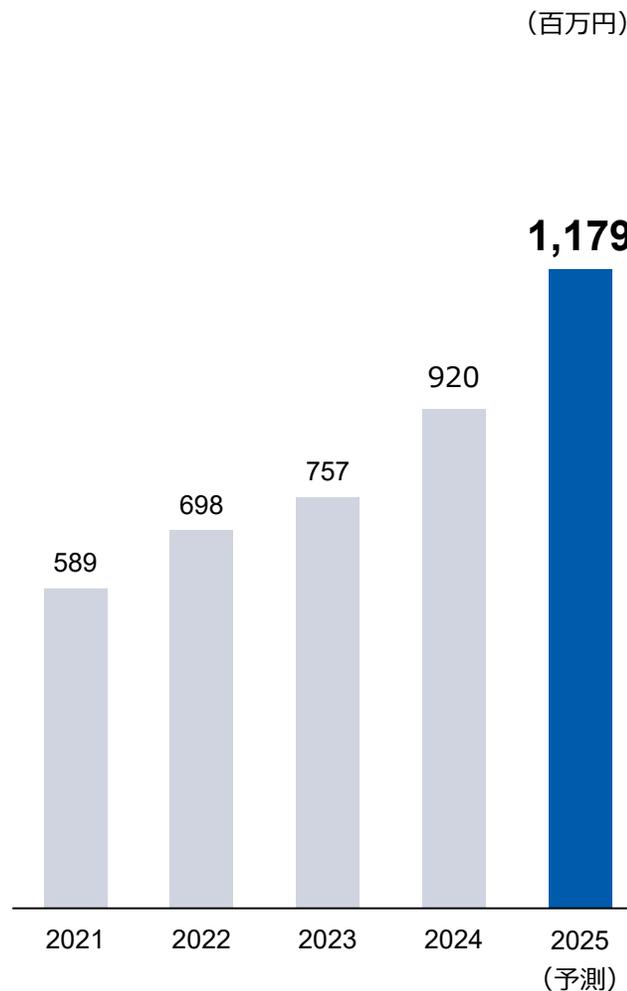
設備投資額

(百万円)



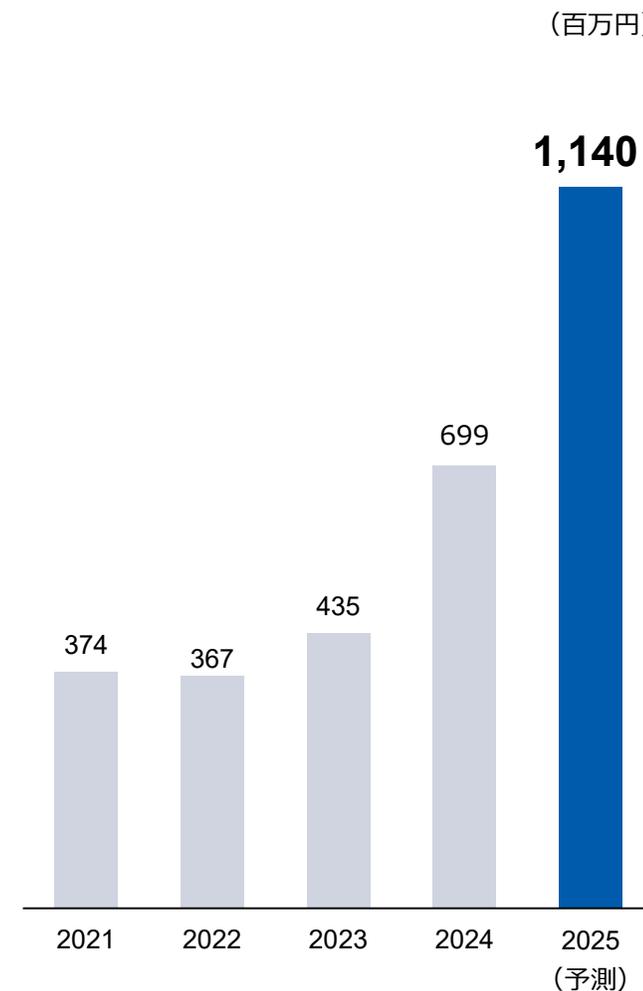
減価償却費

(百万円)



研究開発費

(百万円)



EV市場の投資鈍化によりパワー半導体向け装置は、投資及び出荷の延期となっている案件が出ている。直近では中国市場での投資の再開に取り組みつつ、中長期的な市場の拡大を見込んで今後の投資回復に備えていく。

AI関連市場の拡大に伴い、先端パッケージ技術を使ったデバイスの生産は継続的に拡大している。OSATへの生産ラインの展開も含め、先端パッケージ向け装置の需要は今期も堅調に推移し、生産キャパを拡大し対応していく。

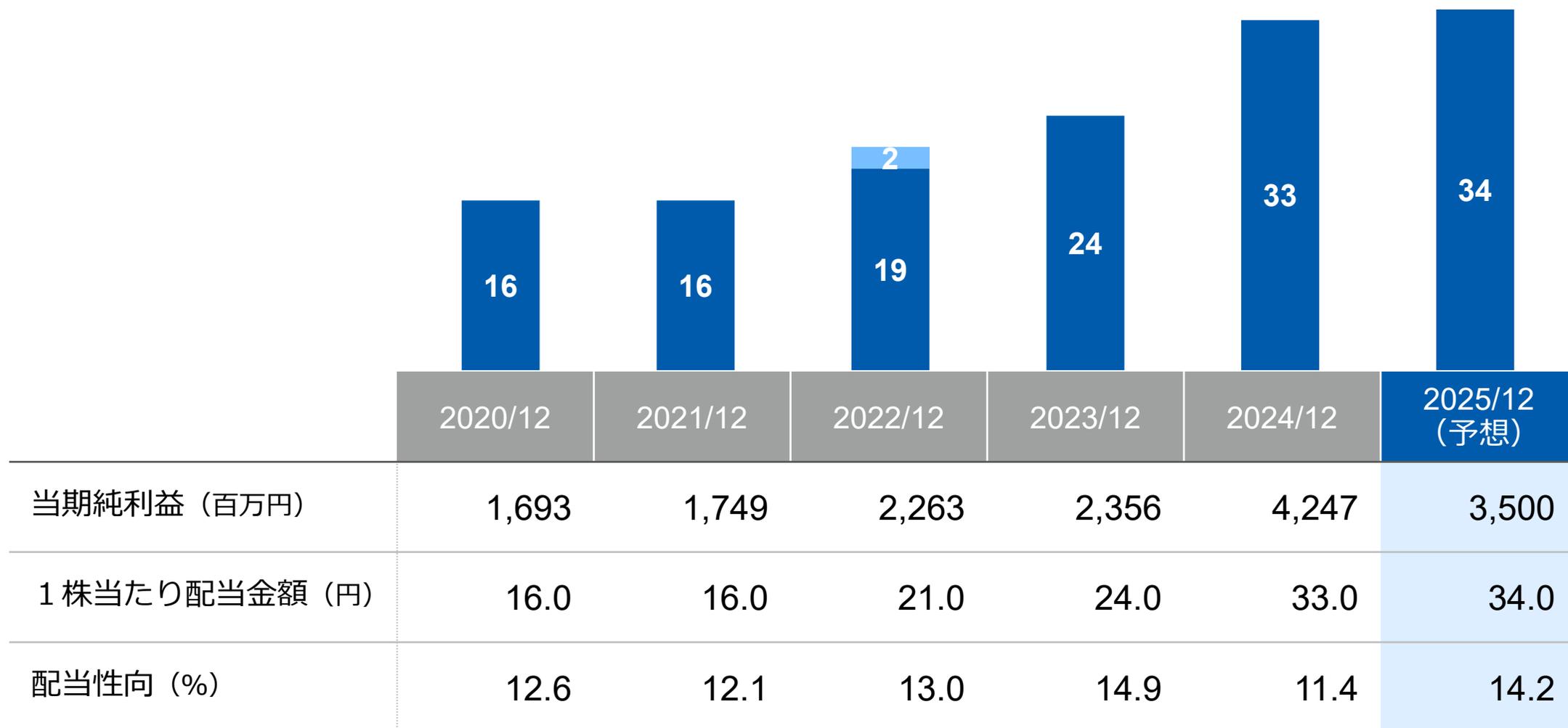
AI向けを中心にパッケージサイズの拡大と生産性向上から、パネル用装置の引き合いが急増。ウェーハ向け装置とFPD装置の知見を活かし、先端パッケージ向けPLP装置のプロセス・装置開発を進め引き合いに対応している。
【コーター】

半導体市場全体の状況のとおり、搬送機器の引き合いの回復にはまだ時間がかかる見込みだが、PLP向けロボットの引き合いは増加中。フレームを含めた搬送機器の受注により注力することで販売単価と収益性の向上を狙う。
【搬送機器】

ウェーハメーカーの投資鈍化の影響を受けて受注は低迷しているが、スラリー供給装置などの個別対応装置の受注販売や、市場の回復時に備えた新規装置の開発を進める。【洗浄機】

自動車需要回復が遅れている状況下で、車載用プリント基板メーカーの投資が鈍化しているが、メッキ装置を中心に一定の引き合いがある。パッケージ基板向けも含め搬送機器の受注に注力している。【表面処理用機器】

■ 普通配当 ■ 50周年記念配当



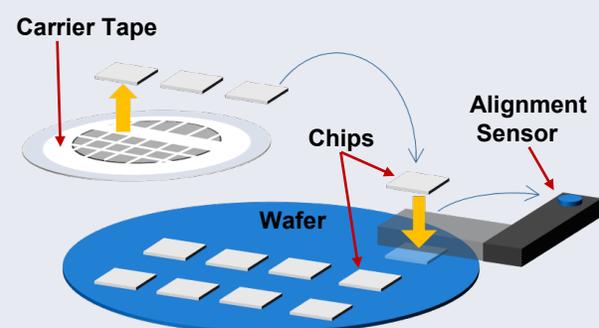
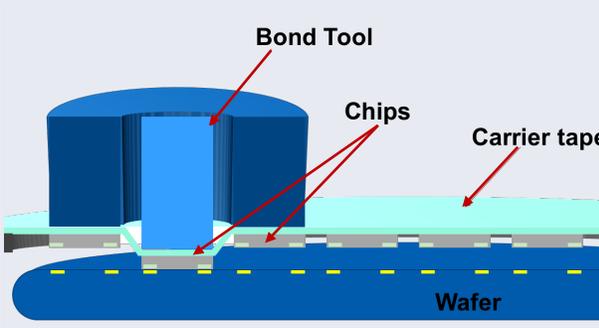


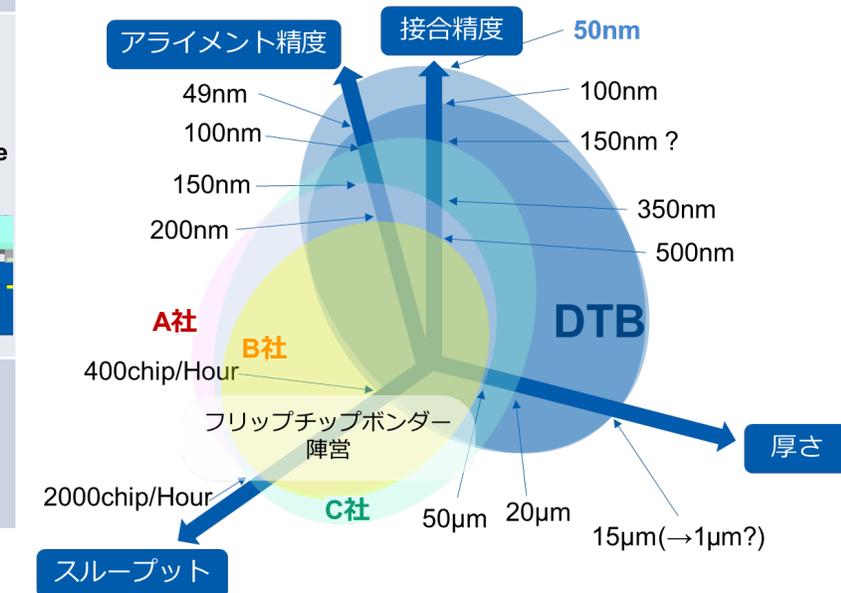
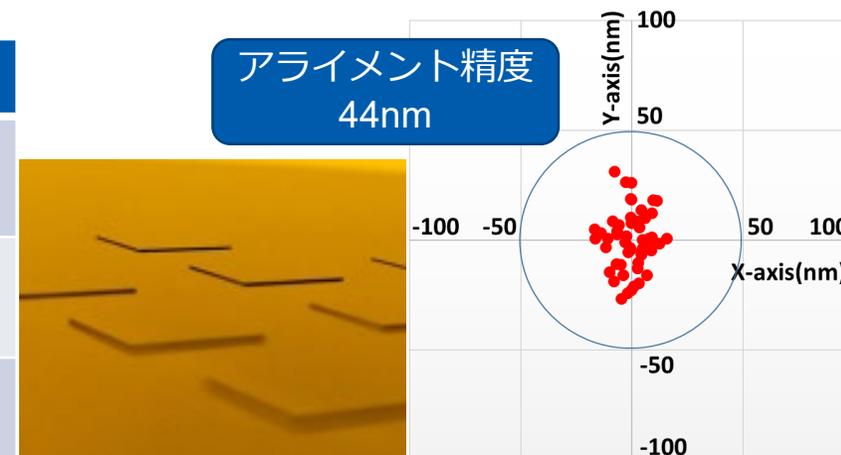
04

新技術紹介

CoW bonder装置 (DTB : Direct Transfer Bonder)

微細化の限界や演算量の増大による電力課題に対し、チップレット技術によるデバイスの高集積化が解決策となると想定し、拡大するチップレット市場に向け新たなCoWボンダー：TAZMO “DTB” を開発しています。

	フリップチップボンダー	TAZMO “DTB”
チップのピックアップ	ある→ チップ汚染の可能性	無い→ 高い清浄度を保持
チップ搬送	チップ毎→ サイズに制約	テープで搬送→ サイズフリー
アライメント	カメラを挿入→ 距離必要で高精度化難しい	テープを通して→ 接合直近で高精度化容易
概略構造		
備考	従来技術：チップを個別に持ち替え搬送し接合する	新技術：チップを持ち替えることなく、キャリアテープから直接ウェーハに接合する

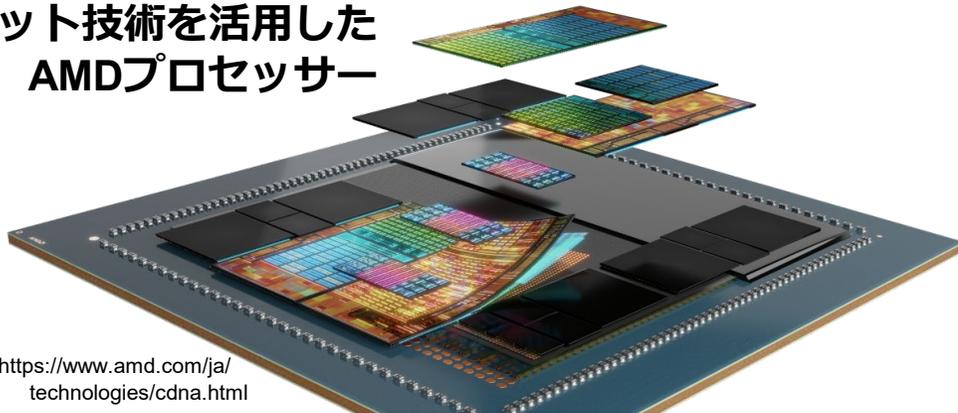


Chiplet Integration Platform Consortium チップレット集積プラットフォーム・コンソーシアムに参加しています

対象となる市場と今後の展望

急激な成長が予測されるチップレット市場に対して追従するべく開発を進めています。投稿が認められ、2025年5月末開催のECTC 2025 Technical Program での発表を行い、更に開発と浸透を進めていきます。

チップレット技術を活用したAMDプロセッサ



引用 : <https://www.amd.com/ja/technologies/cdna.html>



Permalink

Interconnections

Direct Transfer Bonding Technology Enabling 50-nm Scale Accuracy for Die-to-Wafer 3D/Heterogeneous Integration

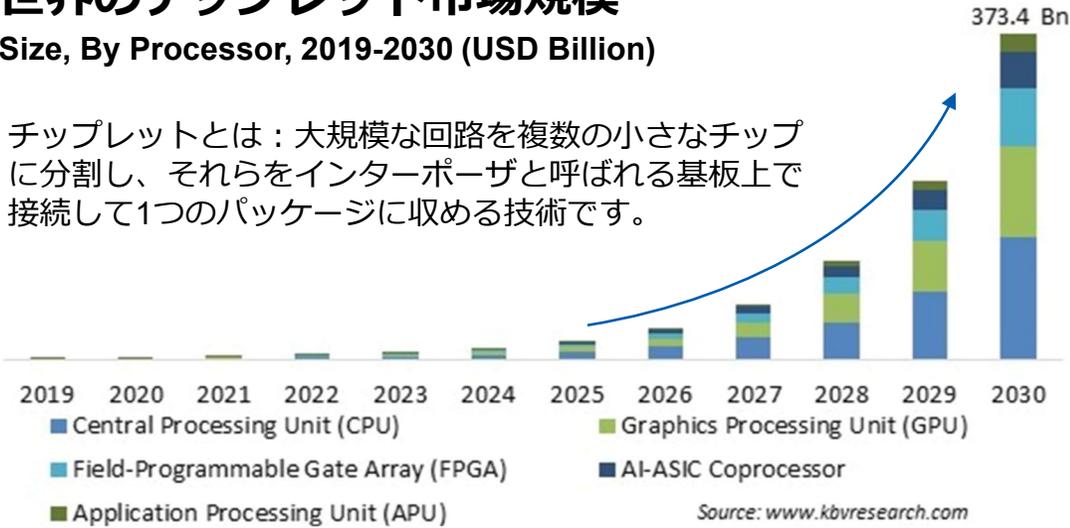
Wed, May 28 | Texas C | Oral Session

Part of: 08 Novel Structures and Processes for Chip-to-Wafer Hybrid Bonding

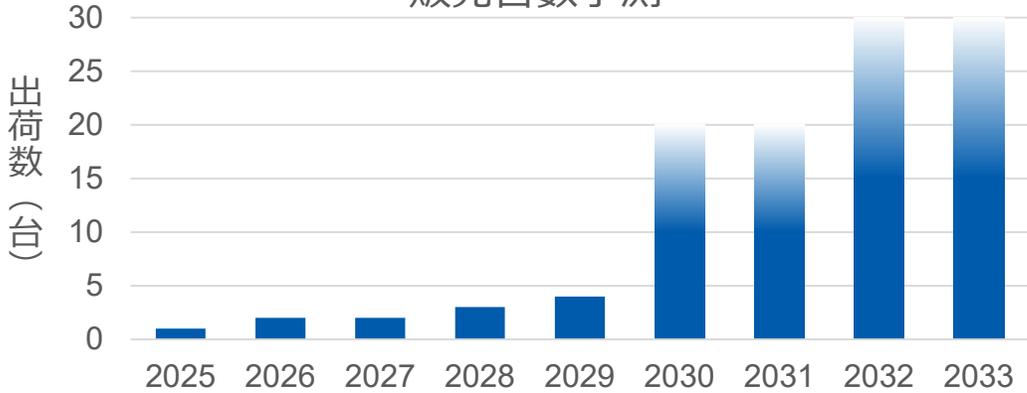
世界のチップレット市場規模

Size, By Processor, 2019-2030 (USD Billion)

チップレットとは：大規模な回路を複数の小さなチップに分割し、それらをインターポーザと呼ばれる基板上で接続して1つのパッケージに収める技術です。



販売台数予測





05

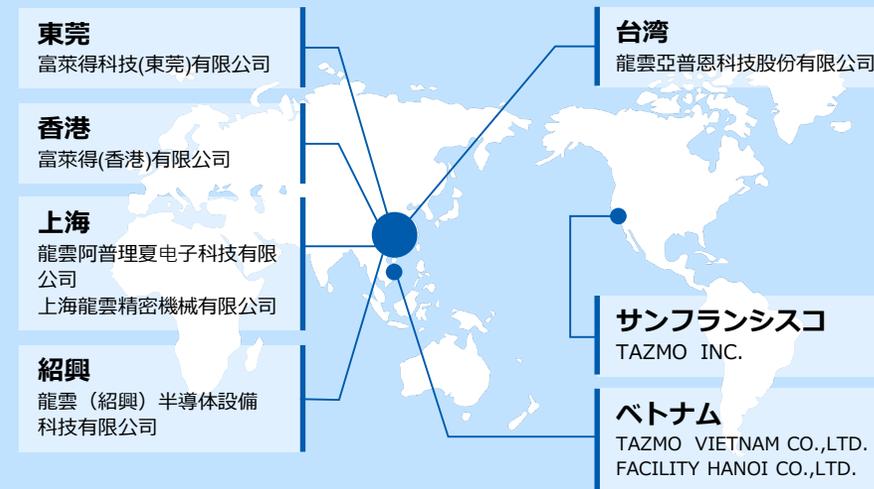
補足資料

商号	タツモ株式会社
設立	1972年（昭和47年）2月26日
本社所在地	岡山県岡山市北区芳賀5311
資本金	35億5,689万682円
発行済株式数	14,842,354株
株主数	8,903名（2024年12月31日現在）
従業員数	単体 414名／連結 1,163名（2024年12月31日現在）
事業内容	半導体製造装置、半導体製造用搬送装置、 液晶製造装置、紫外線照射装置、めっき処理装置、 精密金型・樹脂成形品などの開発・製造・販売

国内拠点・関連子会社



海外拠点



- 1972** ● - 電子機器部品の製造及び設備の修繕を目的として設立
- 1980** ● - インジェクション金型他、金型の製造・販売を開始
- 半導体製造用全自動レジスト塗布装置を開発、製造・販売を開始
- 1989** ● - 液晶用カラーフィルター製造装置を開発、製造・販売を開始
- 1990** ● - 本社・本社工場を新築、岡山県井原市木之子町6186番地に移転
- スーパークリーンルーム用超小型搬送システムを開発、製造・販売を開始
- 1994** ● - エンボスキャリアテープの製造・販売を開始
- 1995** ● - インジェクション成形品の製造・販売を開始
- 2001** ● - 半導体製造用厚膜コーター「CS13」シリーズを開発、
- 製造・販売を開始
- 2004** ● - JASDAQ市場に株式を上場
- 2008** ● - TAZMO VIETNAM CO.,LTD.（ベトナム：ホーチミン市）を設立
- 2009** ● - 第10世代対応カラーフィルター製造装置を開発、製造・販売を開始
- 3M社（米国）と半導体製造装置のライセンス契約を締結
- 2013** ● - アプリシアテクノロジー株式会社を子会社化
- ロンアン省ロンハウ工業団地内にTAZMO VIETNAM CO.,LTD.を移転・新築
- 2017** ● - 株式会社ファシリティ、株式会社クオークテクノロジーを子会社化
- 2018** ● - 東京証券取引所市場第一部へ市場変更
- 2019** ● - 本社を岡山県岡山市北区芳賀5311番地に移転
- 2020** ● - アプリシアテクノロジー株式会社を吸収合併
- 2022** ● - 東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所市場第一部からプライム市場に移行
- 公募増資により、資本金34億9,540万円へ増資
- 中国における半導体関連機器の製造・販売拠点として龍雲（紹興）半導体設備科技有限公司を浙江省紹興市に設立

最先端の半導体やパッケージを製造する装置をはじめ、有機ELや液晶ディスプレイなどの製造装置、クリーン搬送ロボットなどを開発・製造・販売する事業を展開

半導体製造装置事業

半導体製造における塗布・現像・貼合・剥離など、各種プロセスに対応した装置を、40年に渡って培ったノウハウ・技術により、全世界に提供



搬送機器事業

半導体製造に欠かせないシリコンウェーハ等の搬送ロボットをはじめ、正確性・スピーディさ・省スペースに対応した各種搬送システムを提供



洗浄装置事業

半導体製造の重要な工程であるシリコンウェーハ洗浄・スラリー供給装置や、廃液からリン酸を再生・再利用する装置を提供



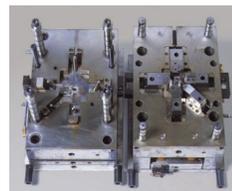
コーター事業

液晶ディスプレイ等、各種フラットパネル製造装置を提供。現在はPLP用装置やナノインプリント装置の開発を進めている。



金型・樹脂成形事業

部品製造に欠かせない金型技術は、創業時からのコア技術であり、ユーザー企業の様々なニーズに応える形で各種製品を提供



表面処理用機器事業

半導体のパッケージや、自動車等の電子制御システムに組み込まれている、プリント回路基板に対するめっき処理装置の提供



当社では、TCFD提言に基づく各種情報開示を行っています。

ガバナンス・リスク管理



- **サステナビリティ委員会を設置**
 - ・ 年2回（4月・10月）の開催
 - ・ 取締役会と連携しながら、推進施策の決定や全社の取り組みを監視
 - ・ 特に環境に対する取り組みは当委員会で方針を決定・各所に共有・報告を実施
- **報告を踏まえ、担当部署にリスク対策を含む事業戦略・中期計画の作成を指示**

戦略



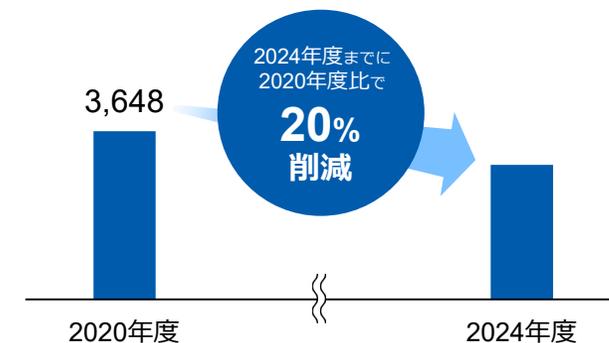
- 将来の気候変動に対するリスクや機会を分析し、財務への影響について特定
- その対策として、下記を順次検討・実施
 - ・ **自家消費型太陽光発電設備の設置（2023年9月施工完了）**
 - ・ **全社照明設備のLED化の推進（2023年3月施工完了）**
 - ・ **再生可能エネルギー由来の電力などへ切り替え**
 - ・ **設備更新などによる電力効率化への取り組み**

指標と目標



- 事業活動を通じたカーボンニュートラルの実現を目指すため、自社のCO2排出量を継続的に把握、削減目標達成のための施策を実行
- CO2排出量については、現状は自社単体での開示を行い、順次グループ全体の排出量把握・削減への取り組み実行を予定

CO2排出量削減目標（2022年～2024年）



本資料の取扱上の注意

本資料は、2025年2月14日発表の決算短信に基づいて作成されております。

また、本資料に記載されている業績予測等は、現在入手可能な情報に基づいて作成されたものであり、実際の業績は様々な要因により予想数値と異なる場合があります。

本資料は投資家の皆様への情報提供のみを目的としたものであり、当社の発行する有価証券売買の勧誘を目的としたものではありません。

本資料に関するお問い合わせ先

タツモ株式会社 経営企画室



086-239-5000



086-239-5100



keiki@tazmo.co.jp